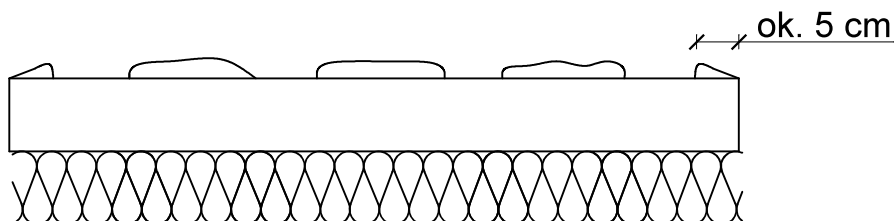


A - A



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 60 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej
przylegająca do ściany

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoża nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 60% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placiki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).



Projekt:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne
Rysunek:	Sposób nakładania kleju na płyty termoizolacyjne

Adres inwestycji:	Ciechocin, 87-408 Ciechocin dz. nr ewid. 378/5
Inwestor:	Gmina Ciechocin Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Zespół projektowy			
Funkcja:	Imię nazwisko:	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Dariusz Rafalski		
Opracował:	mgr inż. Łukasz Dymkowski		

Skala:	Data opracowania:	Format arkusza:	Nr rys.:	Str. w dok.:
----	04.07.2016 r.	A 4	D.4.	47